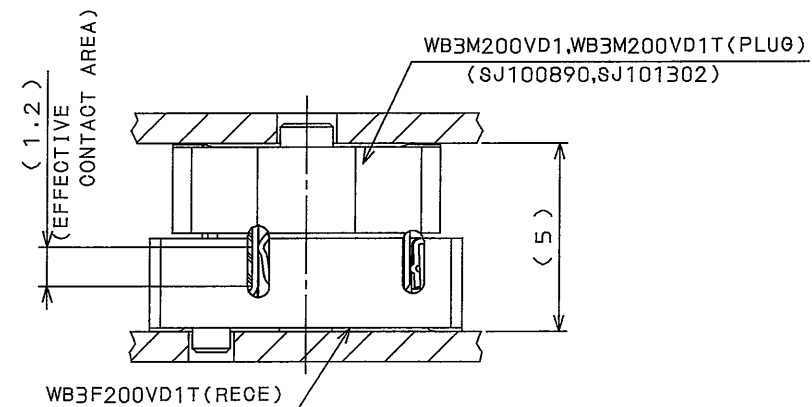
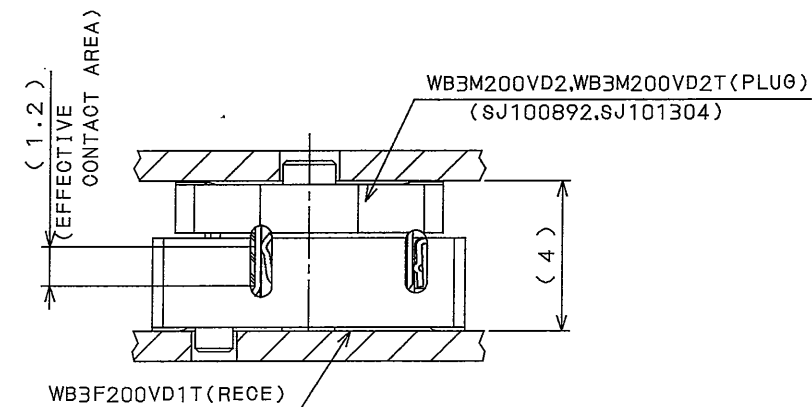
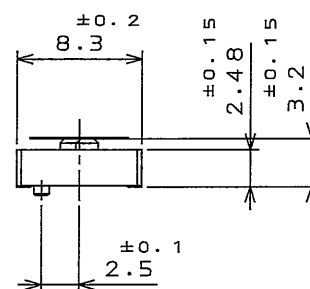
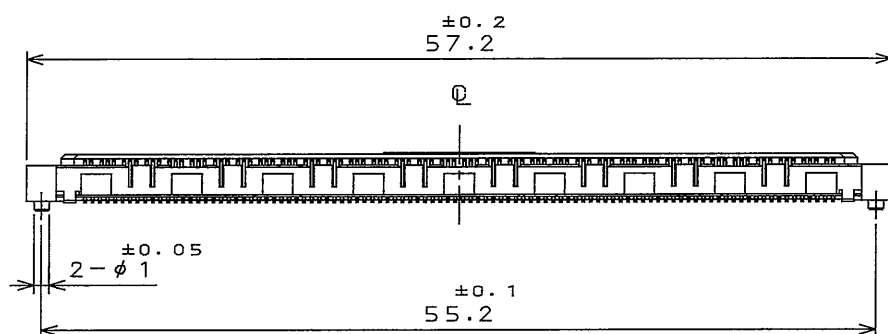
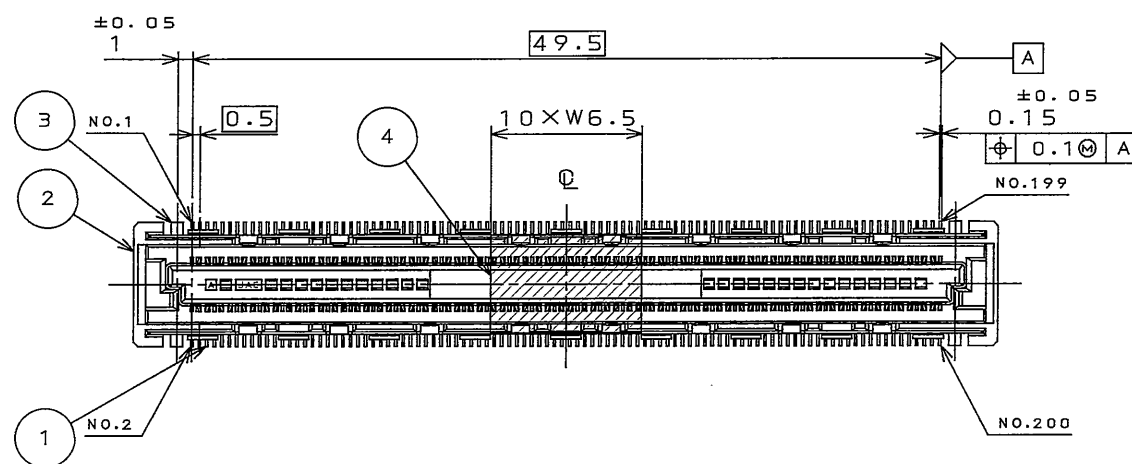


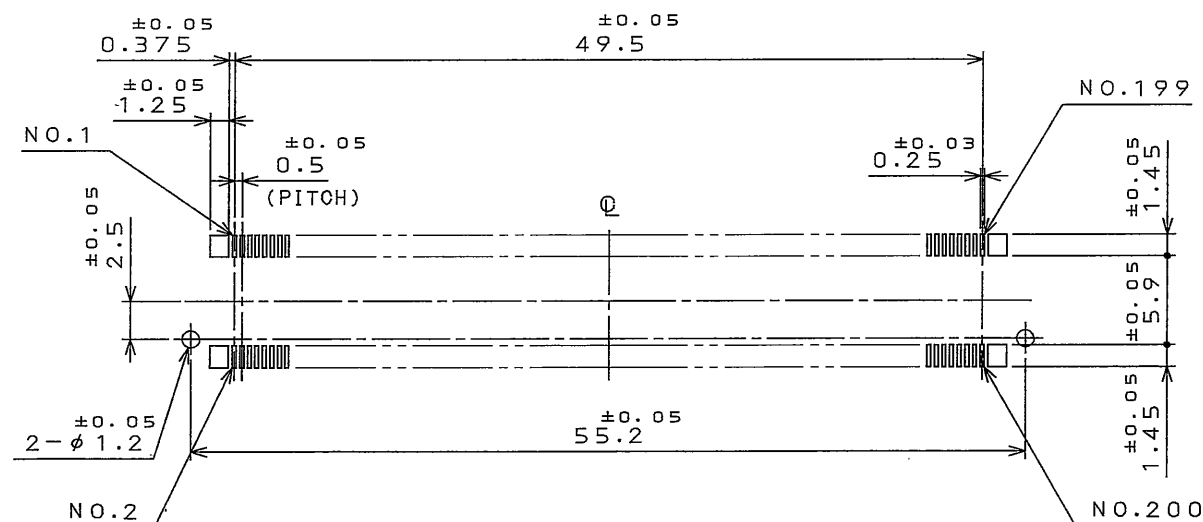
00E101300
(ON ENIMVH) 品名図

版数 REV.	年月日 DATE	CON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図(参考)

NOTE1. COPLANALITY OF SMT TERMINAL IS 0.1 MAX.
注1. コンタクトのコプラナリティは0.1以下とする。



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)

4	HEAT RESISTING TAPE	1	PI		
3	SHELL	2	COPPER ALLOY	REFLOW TIN PLATING	
2	INSULATOR	1	HEAT RESISTING PLASTICS		COLOR: BLACK UL94 V-0
1	CONTACT	200	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD (0.76μm MIN) TERMINAL AREA: GOLD FLASH	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-10174		第1版 (ORIGINAL DATE) 7.Jun.2004		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) WB3
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) WB3F200VD1T RECEPTACLE (WITH TAPE)	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	H.OBIKANE		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	Y.YAHIRO		
		承認 APPD.	S. Kashiwagi		
		重量 (WEIGHT)			
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					図面番号 (DRAWING NO.) SJ101300
版数 (REV.) 1					